

北京君正集成电路股份有限公司 关于公司和全资子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）和全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）自2018年1月1日至2018年6月30日累计获得各项政府补助资金共计人民币925.63万元，具体情况如下：

序号	补助原因/项目	发放主体	获得主体	收到时间	补助金额	与资产相关/与收益相关	会计处理
1	合肥市自主创新政策补助	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年1月	100,000	与收益相关	其他收益
2	高清视频 SoC 芯片研发项目	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年2月	5,390,000	与收益相关	其他收益
3	合肥高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年2月	20,000	与收益相关	其他收益
4	合肥高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年2月	3,071,300	与收益相关	其他收益
5	合肥高新区自主创新政策补助	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年4月	50,000	与收益相关	其他收益
6	合肥高新区集成电路产业政策补助	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年5月	40,000	与收益相关	其他收益

序号	补助原因/项目	发放主体	获得主体	收到时间	补助金额	与资产相关/与收益相关	会计处理
7	合肥高新区产业转型发展专项资金政策补助	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年5月	100,000	与收益相关	其他收益
8	合肥市“228”产业创新团队奖励资金	合肥高新技术产业开发区	合肥君正	2018年5月	275,000	与收益相关	其他收益
9	面向电子书市场的高性能嵌入式处理器芯片研发及产业化金	中关村科技园区管理委员会	北京君正	2018年6月	210,000	与收益相关	其他收益

公司及全资子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助，截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。

上表中的第2项和第3、4项，全资子公司合肥君正获得的“高清视频 SoC 芯片研发项目”的补助资金 539 万元、“合肥高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金”合计 309.13 万元已经披露，详见公司分别于 2018 年 2 月 6 日和 2018 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-013、2018-015）。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司及全资子公司将根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均与日常经营相关，不具有可持续性，均为与收益相关的政府补助。

根据“高清视频 SoC 芯片研发项目”项目申请报告，该研发项目执行期为自 2017 年 1 月 10 日至 2019 年 12 月 30 日，合肥君正将自收到项目支持资金当月起至项目结束日分期结转入其他收益，预计将会增加公司 2018 年度利润约 257 万元，增加公司 2019 年度利润约 282 万元。其余政府补助资金 386.63 万元根据补助内容拟全部计入 2018 年度其他收益。

三、风险提示和其他说明

1、公司及全资子公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使

用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；

2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、有关补助的政府批文
- 2、收款凭证

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日